

泰國搶佔全球半導體與 PCB 機遇

資料蒐集：駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組

泰國投資委員會（BOI）攜手產學界舉辦論壇，討論戰略方針，推動泰國成為區域電子製造領導基地，特別聚焦半導體與高階印刷電路板（PCB）。

在全球貿易規則與供應鏈劇烈變動之際，泰國展示了電子製造生態系的完善條件，並著手推動上下游投資措施、人才培育，以承接未來產業需求。僅 PCB 領域就吸引逾 2,000 億泰銖(1 銖約 0.94 台幣)投資，國際廠商積極響應，形成龐大投資潮。

◆7,000 億泰銖投資湧入 半導體與 PCB 成新興集群

在 2025 年 8 月 20 日 曼谷 BITEC 會展中心舉辦的 Thailand Electronics Circuit Asia 2025 (THECA 2025) 期間，BOI 舉辦 “Building the Future: Investment Policies Shaping Thailand’s Advanced Electronics and Semiconductor Ecosystem” 論壇，邀集政府、企業與學術界共同探討戰略與願景。

BOI 秘書長 Narit Therdsteeerasukdi 表示，自 2022 年至 2025 年 6 月，泰國累計吸引超過 500 個投資專案、總額逾 7,000 億泰銖，其中 PCB 領域有 180 個專案，投資總額逾 2,000 億泰銖。世界級製造商紛紛在泰國設立大型基地，促成全新產業集群，為泰國經濟長期成長奠定基礎。

推升需求的因素包括：數位轉型與 AI 改變消費需求；電動車、電池、資料中心、機器人與自動化急速成長；全球貿易戰與科技戰 使半導體成為各國戰略核心，企業加速調整供應鏈以分散風險。這些變化為泰國搶佔投資機會，並推動產業結構升級提供契機。

◆泰國優勢：完整基礎建設與政策支持

泰國具備多項強項，包含穩定的水電與潔淨能源、完善工業園區、物流與上下游供應鏈及政府積極支持。

Narit 強調，BOI 正與全球顧問公司合作制定半導體戰略藍圖，未來 1-2 個月將提交審議。新戰略將凸顯泰國不僅是製造基地，還能成為研發中心、高技能人才培育中心與區域供應鏈核心。

◆產學界觀點與投資建議

Silicon Craft Technology（IC 設計）：若獲政策支持，2030 年前泰國可新增 5 家 IC 設計公司，2035 年前再增 10 家。政府應推動公私部門採用泰國晶片，並啟動晶圓廠（Wafer Fab）投資計畫。

UTAC Thai（封裝測試）：泰國有能力發展 MEMS 與高階感測器，如加速度計、

陀螺儀、壓力與濕度感測器，將成為智慧裝置核心。

Lumentum International (EMS)：強調集群合作、先進自動化、零缺陷品質與精準檢測，將使泰國企業更具競爭力。

泰國微電子中心 (TMEC)：指出泰國具備成為先進封裝與特殊半導體區域中心的條件，尤其在 **AI** 與人形機器人時代。

泰國 PCB 協會：全球市場對 **EV**、**AI** 伺服器、高速通訊 **PCB** 需求快速增加，泰國需投資新製程技術（雷射鑽孔、直寫光刻等），並於 **5** 年內培育至少 **8** 萬名專業人才。

NXPO（高教科研創新政策辦）：呼籲立即行動，不可等待「合適時機」，需立刻推動人才培育與產學合作。首階段（**2026 - 2030** 年）計劃培養 **8.4** 萬名高技能人才、**1,700** 名專業研究人員，並設立 **6** 個培訓中心。